

小型スパッタリング装置

Compact Sputtering System

高周波スパッタリング装置 RFS-200

概要

真空蒸着よりも緻密で高精度な薄膜を再現性よく形成し、真空蒸着では不可能だった高融点物質の成膜も可能なスパッタリング装置です。

特長

1. 金属、半導体、絶縁物の成膜が可能です。
2. コンパクトで設置場所を取りません。
3. 電源は一次側100V、15Aで使用でき、出力は200W水晶制御方式で、スパッタ速度は20nm/min(SiO₂ が得られます)。
4. 真空計、温度指示調整計、安全操作用の非常警報器など必要な計器類は組み込まれております。
5. オプション追加により機能向上が可能です。

Compact radio frequency Sputtering System

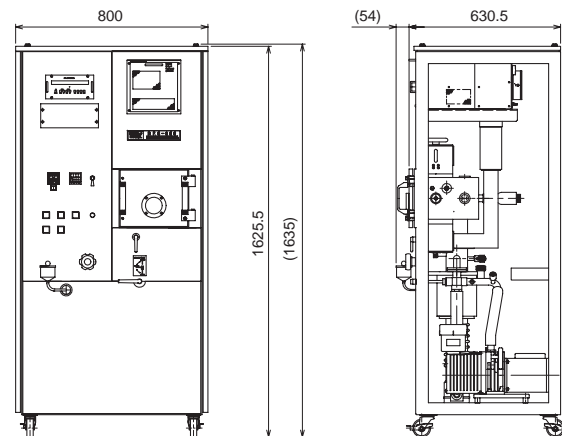
小型スパッタリング装置

高周波スパッタリング装置

RFS-200

Optional Parts

- ・電離真空計



側面扉を開いた状態

仕様 Specifications

ターゲット Standard target	80 1~5t
真空槽 Vacuum chamber	200mm(W)×250mm(D)×150mm(H) SUS-304 前面扉式
基板 Substrate electrode	80mm Cu製 加熱・冷却式
カソード Cathode	80mm Cu製 冷却
シャッター Shutter	95mm×1t 手動操作
RF電源 RF power supply	200W 13.56MHz
基板加熱電源 Power supply for substrate heating	デジタル自動温度調節 Max 350
排気系 Vacuum system	油拡散ポンプ 240 ¹ /sec. 油回転真空ポンプ 100 ¹ /min.
外形寸法・質量 Dimensions・Weight	800mm(W)×630mm(D)×1625.5mm(H) 200kg
所要電力 Power requirement	1 100V 1.3kVA
質量 Weight	200kg
冷却水量 Cooling water requirement	200kPa、5 L/min 25 以下
到達圧力 Ultimate pressure	6.7×10 ⁻⁴ Pa
排気時間 Evacuation time	10 ⁻³ Pa台5min.
スパッタ圧力 Sputtering pressure	10 ⁻¹ Pa Ar

オプションパーツ Optional parts

液体窒素トラップ	電離真空計
マグネトロン	インライトラップ(OMI-100)
ターボ分子ポンプ	DC電源 500W
導入ガス2系統、3系統	油回転真空ポンプ自動リークバルブ

写真のOptional partsは標準装備していません。

ドライ仕様等ご要望に応じてカスタマイズいたします。お気軽にお問い合わせください。